

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 5 月 19 日 (2005.5.19)

【公開番号】特開 2003-163237(P2003-163237A)
【公開日】平成 15 年 6 月 6 日 (2003.6.6)
【出願番号】特願 2002-331827(P2002-331827)
【国際特許分類第 7 版】
H 0 1 L 21/60
【F I】
H 0 1 L 21/60 3 1 1 Q

【手続補正書】
【提出日】平成 16 年 7 月 14 日 (2004.7.14)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

ハンダカラムアレイを有し少なくとも 1 つの非接続場所を有する回路構成要素を回路基板上で支持する方法であって、前記少なくとも 1 つの非接続場所において前記回路構成要素と前記回路基板との間に剛性カラムを配設するステップを含む、方法。

【請求項 2】

前記回路構成要素が複数の非接続場所を有しており、前記複数の非接続場所のうちの少なくとも幾つかの非接続場所において前記回路構成要素と前記回路基板との間に剛性カラムを配設する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記剛性カラムが、高燐青銅及びコパールの少なくとも一方から作成される、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

ハンダカラムアレイを有し少なくとも 1 つの非接続場所を有するカラムグリッドアレイ集積回路パッケージをプリント回路基板上に支持する方法であって、前記少なくとも 1 つの非接続場所において前記プリント回路基板と前記カラムグリッドアレイ集積回路パッケージとの間に剛性カラムを配設するステップを含む、方法。